

DIN IEC/TR 62627-01:2011-02 (D)

Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Teil 01: Reinigungsverfahren für Lichtwellenleiter-Steckverbinder (IEC/TR 62627-01:2010)

Inhalt	Seite
Nationales Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Begriffe	4
3 Allgemeines	4
3.1 Notwendigkeit der Reinigung von LWL-Verbindungen	4
3.2 Was ist die Quelle der Verschmutzung?	5
3.3 Was ist zur Reinigung erforderlich?	7
3.4 Auswirkungen der Verschmutzungen	8
3.5 Wann ist Reinigung erforderlich?	9
4 Prüfeinrichtung	9
4.1 Allgemeines	9
4.2 Prüfeinrichtung für das Reinigen freiliegender Steckverbinder-Endflächen	9
4.3 Prüfeinrichtung zur Reinigung der Anschlüsse	10
4.4 Reinigungsmaschinen	10
4.5 Prüfeinrichtung	11
5 Durchführung	11
5.1 Allgemeines	11
5.2 Verfahren zur Reinigung frei liegender Steckverbinder-Endflächen	12
5.3 Verfahren zur Reinigung von Anschlüssen	12
6 Erfahrungen	14
Literaturhinweise	16
Bilder	
Bild 1 - Typische Beispiele für Verschmutzungen	6
Bild 2 - Ergebnisse der Steckung	7
Bild 3 - Migration der Schmutzstoffe	7
Bild 4 - Signalverschlechterung aufgrund von Verschmutzungen	8
Bild 5 - Bleibende Beschädigungen durch Verschmutzungen	9
Bild 6 - Prüfung eines Verbindungskabels und einer Kupplung	11
Bild 7 - Grundlegender Ablauf	11
Bild 8 - Trockene Reinigung	12
Bild 9 - Reinigung von Anschlüssen	13